

Labor für elektrische Baugruppen und Mechatronik



SMD- Bestückungsautomat HE 50 Twin

Leiter

Prof. Dr. rer. nat. Frank Köster

Prof. Dr.-Ing. Peter Hübner

Mitarbeiter

Dipl.-Ing. Eckhard Drechsel

Allgemein

Montage- und Verbindungstechnik von elektrischen, elektronischen und mechanischen Baugruppen

Ausstattung

- SMD-Bestückungsautomat HE 50 Twin (HEEB GmbH)
 - Bestückung von Bauelementeträgern mit aufsetzbaren Bauelementen
 - Nutzformat max. 380 mm x 315 mm
 - bestückbare Bauformen 0805 bis PLCC44
- Reflow -Lötöfen HR 240/15
- Lötén der SMD -Bauelemente, Aushärten von Klebstoff;
 - Arbeitsbreite 240 mm
- Schwallötmaschine HWL 240
 - Schwallötén der Bauelemente
 - Arbeitsbreite 240 mm
- Schablonendrucker (Eigenbau)
 - Druck von Lotpaste und Kleber
 - Druckbereich (150 - 200) mm
- Manueller Drahtbonder MDB 10
 - zur Verbindung der Kontaktflächen von Halbleiterbauelementen mit den Anschlüssen der verschiedensten Bauelementeträger durch Ziehen von Drahtbrücken mittels Ultraschall - Schweißverfahren
 - Draht: Aluminium und Al - Legierungen
 - Drahtdurchmesser (25-50) μm

Nutzbar

- Bestückung von Bauelementeträgern mit aufsetzbaren Bauelementen, Nutzformat max. 380 x 315 mm (bestückbare Bauformen 0805- PLCC 44
- Lötén der SMD - Bauelemente, Aushärten von Klebstoff (Arbeitsbreite 240 mm)
- Schwallötén (Arbeitsbreite 240 mm)
- Ultraschallbonden

Kontaktadresse

Hochschule Mittweida
Fakultät Maschinenbau
Technikumplatz 17
09648 Mittweida

Tel.: 03727 / 58 15 32 od. 58 14 60
Fax: 03727 / 58 13 76
koester@hs-mittweida.de,
huebner2@hs-mittweida.de